

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：0981)

中芯截至二零零五年三月三十一日止三个月业绩公布

- 本公司谨于今日公布截至二零零五年三月三十一日止三个月的未经审核经营业绩。销售额由上季的 291,800,000 元降至二零零五年第一季的 248,800,000 元，降幅 14.7%。月产能增至 131,172 片 8 吋等值晶圆。二零零五年第一季的使用率为 85%，二零零四年第四季为 95%。二零零五年第一季的毛利率为 3.4%，二零零四年第四季为 20.3%。二零零五年第一季的净亏损为 30,000,000 元，二零零四年第四季为净亏损 11,200,000 元。
- 以下为本公司于二零零五年四月二十九日就截至二零零五年三月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。
- 本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任而作出本公布。

所有货币数字均以美元列账，除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

中芯二零零五年第一季业绩报告

概要

- 销售额由上季的 291,800,000 元降至二零零五年第一季的 248,800,000 元，降幅 14.7%。
- 月产能增至 131,172 片 8 吋等值晶圆。
- 二零零五年第一季的使用率为 85%，二零零四年第四季为 95%。
- 二零零五年第一季的毛利率为 3.4%，二零零四年第四季为 20.3%。
- 二零零五年第一季的净亏损为 30,000,000 元，二零零四年第四季为净亏损 11,200,000 元。

中国上海—二零零五年四月二十九日—国际主要半导体承包制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零五年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。二零零五年第一季销售额由上一季度的291,800,000元下降14.7%至248,800,000元。本公司二零零五年第一季的月产能增至131,172片8吋等值晶圆，使用率为85%。二零零五年第一季的毛利率为3.4%而二零零四年第四季为20.3%。二零零五年第一季的净亏损为30,000,000元，二零零四年第四季则为净亏损11,200,000元。

“由于整个行业疲软和晶圆代工产业的严峻竞价的环境，我们二零零五年第一季的销售额正如预期的那样下降了15%”，中芯国际总裁兼总执行长张汝京先生说：“但是，我们为0.18微米及0.18微米以下的产品在本季增长了11.6%而振奋。此增长的部分应归功于本季北京四厂—我们第一个12吋晶圆厂，成功为第一个客户生产并付运了产品。在第二季度，由于客户的存货量下降，我们预见下半年的客户需求将有所增长。这种趋势加之我们不断地实行我们的经营策略，将使我们的经营环境得以改善。

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零五年四月二十九日

时间：上海时间上午八时正

拨号及登入密码：美国 1-617-786-4501（密码：SMIC）或香港852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零五年第一季业绩公布网上直播可于 www.smics.com 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

有关中芯

中芯国际(NYSE: SMI, SEHK: 0981.HK)是世界领先的集成电路芯片代工厂之一，提供0.35微米到 0.11 微米及更先进工艺的芯片制造服务。公司 2000 年成立以来，其位于上海及天津的四座 8 英寸芯片均已量产。另外，其位于北京的 12 英寸芯片厂也于 2005 年第一季度开始量产。中芯国际还在美国、欧洲、日本、香港等地设立了办事处，更好地服务于全球客户。中芯国际致力于提供高品质的服务，全面执行国际标准，目前已经通过了 ISO9001 认证、ISO/TS16949 认证、OHSAS18001 认证、TL9000 认证以及 ISO14001 认证。如需更多信息，敬请访问公司网站：<http://www.smics.com>

安全港声明

（根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据1995私人有价证券诉讼改革法案所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，为并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知风险、不确定性，以及其它可能导致中芯实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体承包制造服务供求情况、市场产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（「证交会」）的文件资料，包括其于零四年三月十一日以 F-1 表格（经修订）形式呈交予证交会的登记声明，特别是「风险因素」及「有关财务状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份、其于二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港联合交易所（「香港联交所」）的登记声明以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件，包括 6-K 表格。其它未知或不可逆料的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素，

本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则本新闻发布日期）的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Jimmy Lai

投资者关系部负责人

电话：86-21-5080-2000，内线 16088

传真：86-21-5080-3619

Calvin Lau

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16693

传真：86-21-5080-3619

Hermine Wong

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16198

传真：86-21-5080-3619

概要：

以千美元为单位（百分比，每股盈利除外）

	<u>二零零五年</u> <u>第一季度</u>	<u>二零零四年</u> <u>第四季度</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零四年</u> <u>第一季度</u>	<u>年度比较</u>
销售	248,808	291,842	-14.7%	186,937	33.1%
销售成本	240,277	232,725	3.2%	126,781	89.5%
毛利	8,531	59,117	-85.6%	60,156	-85.8%
经营开支	30,505	82,505	-63.0%	33,313	-8.4%
经营溢利	(21,974)	(23,388)	6.0%	26,843	-
其它收入	(8,012)	12,358	-	609	-
收入（亏损）净额	(29,995)	(11,216)	-167.4%	27,452	-
视为优先股派付的股息	-	-	-	(18,839)	-
普通股持有人应占收入	(29,995)	(11,216)	-167.4%	8,613	
毛利率	3.4%	20.3%		32.2%	
经营利润率	-8.8%	-8.0%		14.4%	
每股基本盈利—每股普通股(1)	(\$0.0017)	(\$0.0006)		\$0.0033	
每股基本盈利—每股美国预托股份	(\$0.0831)	(\$0.0311)		\$0.1630	
每股摊薄盈利—每股普通股	(\$0.0017)	(\$0.0006)		\$0.0005	
每股摊薄盈利—每股美国预托股份	(\$0.0831)	(\$0.0311)		\$0.0273	
付运晶圆（8吋等值）(2)	284,912	303,796	-6.2%	174,325	63.4%
综合平均售价	\$829	\$917	-9.6%	\$1,008	-17.8%
逻辑平均售价(3)	\$967	\$1,020	-5.2%	\$1,081	-10.5%
产能使用率	85%	95%		99%	

附注：

(1) 基于二零零五年第一季加权平均普通股 18,054,000,000 股，二零零四年第四季 18,006,000,000 股，二零零四年第一季 2,641,000,000 股。

(2) 包括铜接连件

(3) 不包括铜接连件

• 销售额降至 248,800,000 元，较二零零四年第四季的 291,800,000 元录得季度降幅 14.7%，并较二零零四年第一季的 186,900,000 元录得年度升幅 33.1%。导致此等下降的主要因素如下：

- 晶圆付运降至 284,912 片，较二零零四年第四季的 303,796 片录得季度降幅 6.2%；
- 综合 ASP 由上季的 917 元降至 829 元，录得季度降幅 9.6%

- 销售成本从二零零四年第四季的 232,700,000 元增加到二零零五年第一季的 240,300,000 元，主要由于折旧费用增加，以及由于市场预期价值的下降引起的存货价值下调，于本季下调了 8,900,000 元而二零零四年第四季只下调了 3,800,000 元。
- 二零零五年第一季毛利降至 8,500,000 元，较二零零四年第四季的 59,100,000 元录得季度降幅 85.6%并较二零零四年第一季的 60,200,000 元录得年度降幅 85.8%。
- 毛利率从二零零四年第四季的 20.3%降至 3.4%，主要是由于晶圆产量下降，折旧费用的增加和由于 DRAM 的价格下调和整个行业的疲软造成的综合 ASP 的下降。
- 二零零五年第一季研发费用下降至 17,900,000 元，较上季的 27,400,000 元下降 34.6%，主要由于北京四厂非经常性工程开业成本于二零零四年第四季，因尚未正式量产而作为研发费用列支；而在二零零五年第一季，以上费用随着北京四厂的量产，列支为销售成本。
- 一般行政费用(包括汇兑损益)从二零零四年第四季 25,500,000 元下降 74.1%至 6,600,000 元，差额主要因为本季与经营活动（如应收账款或应付账款）相关的汇兑收益为 3,600,000 元，二零零四年第四季为损失 11,300,000 元；诉讼费用和坏帐准备的减少。
- 经营溢利（亏损）由二零零四年第四季的亏损 23,400,000 元改善为亏损 22,000,000 元，二零零四年第一季为盈利 26,800,000 元。
- 其它非营业性溢利由二零零四年第四季的收益 12,400,000 元下降为本季的亏损 8,000,000 元。主要是因与融资或投资活动（如远期合约归类为其它业务收入/支出）相关的非经营性活动产生的汇兑损失 2,300,000 元，而二零零四年第四季为盈利 13,300,000 元；二零零五年第一季的利息支出由二零零四年第四季的 4,600,000 元增加 3,100,000 元至 7,700,000 元。
- 汇兑净收益为 1,300,000 元，其中一般行政费用中包括了汇兑收益 3,600,000 元。与融资或投资活动相关的非经营性活动产生的汇兑收益 2,300,000 元归类为其它经营性溢利(亏损)。
- 二零零五年第一季净损失为 30,000,000 元，二零零四年第四季为净损失 11,200,000 元，二零零四年第一季的盈利为 27,500,000 元。

1. 收入分析

销售分析					
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以应用分类	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
计算机	36.8%	26.8%	20.5%	22.5%	25.1%
通讯	44.5%	58.1%	57.2%	54.3%	56.0%
消费	13.6%	10.2%	17.1%	17.1%	12.7%
其它	5.1%	4.9%	5.2%	6.1%	6.2%
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以装置分类	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
逻辑（包括铜接件）	61.9%	75.1%	77.6%	73.5%	72.4%
DRAM（1）	33.0%	20.4%	17.5%	20.8%	21.6%
其它（光罩制造及探测）	5.1%	4.5%	4.9%	5.7%	6.0%
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以客户类别分类	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
非厂房半导体公司	48.1%	50.2%	35.3%	36.1%	36.6%
集成装置制造商	49.6%	47.5%	56.3%	54.8%	54.0%
系统公司及其它	2.3%	2.3%	8.4%	9.1%	9.4%
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以地区分类	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
北美洲	40.4%	34.9%	41.8%	44.0%	41.4%
亚太区（不包括日本）	26.9%	43.5%	31.5%	26.5%	27.2%
日本	8.0%	8.8%	15.6%	16.2%	16.3%
欧洲	24.7%	12.8%	11.1%	13.3%	15.1%
晶圆收入分析					
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以技术分类 （仅包括逻辑、记忆及铜连接件）	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
0.13 微米	29.2%	13.8%	11.9%	9.9%	10.1%
0.15 微米	12.5%	14.9%	13.2%	13.3%	15.7%
0.18 微米	40.3%	33.6%	46.2%	48.6%	44.4%
0.25 微米	4.6%	6.0%	6.4%	8.3%	8.3%
0.35 微米	13.4%	31.7%	22.3%	19.9%	21.5%

以逻辑分类 (2)	二零零五年	二零零四年	三零零四年	二零零四年	二零零四年
	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
0.13 微米	5.4%	2.4%	1.8%	0.9%	0.0%
0.15 微米	2.2%	5.3%	4.6%	3.9%	4.4%
0.18 微米	59.8%	38.2%	56.2%	63.0%	58.5%
0.25 微米	7.1%	7.8%	6.1%	3.1%	5.0%
0.35 微米	25.5%	46.3%	31.3%	29.1%	32.1%

附注:

(1) 先前所用的是“内存”一词，但是所有历史报告在这个类别中都仅仅包括 DRAM 装置。

(2) 不包括 0.13 微米铜接连件

- 相较二零零四年第四季而言，二零零五年第一季计算机类别的销售额较其它应用技术增长更快。
- 二零零五年第一季逻辑晶圆(包括铜接连件) 的销售百分比下降至占销售额的 61.9%，二零零四年第四季则为 75.1%而二零零四年第一季则为 72.4%。
- 二零零五年第一季源自北美和欧洲客户的销售百分比分别上升至 40.4%和 24.7%，二零零四年第四季度则分别为 34.9%和 12.8%。
- 二零零四年第四季 0.18 微米及以下技术的销售百分比占销售额上升至 82.0%，二零零四年第四季度为 62.3%而二零零四年第一季度为 70.2%。

产能:

厂 / (晶图尺寸)	二零零五年第一季	二零零四年第四季
一厂 (8 吋)	45,731	45,536
二厂 (8 吋)	40,000	35,870
四厂 (12 吋)	10,220	7,027
七厂 (8 吋)	16,221	14,182
每月晶圆装配总产能	112,172	102,615
铜接连件:		
三厂 (8 吋)	19,000	17,802
每月铜接连件总产能	19,000	17,802

注（1） 期末每月晶圆计，8 吋等值

- 截至二零零五年第一季度终结时，每月产能增加至 131,172 件 8 吋等值晶圆。

付运及使用率：

<u>8 吋晶圆</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>三零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>	<u>第三季</u>	<u>第二季</u>	<u>第一季</u>
付运晶圆（包括铜接连件）	284,912	303,796	263,808	201,534	174,325
使用率 ⁽¹⁾	85%	95%	99%	99%	99%

附注：

(1) 使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零五年第一季晶圆付运量为 284,912 件 8 吋等值晶圆，分别较二零零四年第四季的 303,796 片及二零零四年第一季度的 174,325 片分别下降 6.2%及上升 63.4%。
- 二零零五年第一季使用率下降至 85%。

综合平均售价趋势

逻辑平均售价趋势 （不包括 0.13 微米铜接连件）

二零零五年第一季综合平均售价分别由二零零四年第四季的 917 元及二零零四年第一季的 1008 元下降至 829 元，主要原因在于 DRAM 的价格下调和整个行业的疲软。

二零零五年第一季逻辑平均售价（不包括 0.13 微米铜接连件）由二零零四年第四季的 1,020 元及二零零四年第一季的 1,081 元下降至 967 元，主要原因在于整个行业的疲软及晶圆代工企业严峻的竞价环境。

2. 详细财务分析

毛利分析

<u>以千美元计(百分比除外)</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零四年</u>	<u>年度比较</u>
	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>		<u>第一季</u>	
销售成本	240,277	232,725	3.2%	126,781	89.5%
折旧和摊销	145,307	130,839	11.1%	64,423	125.6%
其它制造成本	94,970	101,886	-6.8%	62,358	52.3%
毛利	8,531	59,117	-85.6%	60,156	-85.8%
毛利率	3.4%	20.3%		32.2%	

- 销售成本从二零零四年第四季的 232,700,000 元增加到二零零五年第一季的 240,300,000 元，主要由于折旧费用增加，以及由于市场预期价值的下降引起的存货价值下调，于本季下调了 8,900,000 元而二零零四年第四季只下调了 3,800,000 元。
- 二零零五年第一季毛利降至 8,500,000 元，较二零零四年第四季的 59,100,000 元录得季度降幅 85.6% 并较二零零四年第一季的 60,200,000 元录得年度降幅 85.8%。
- 毛利率从二零零四年第四季的 20.3% 降至 3.4%，主要是由于晶圆产量下降，折旧费用的增加和由于 DRAM 的价格下调和整个行业的疲软造成的综合 ASP 的下降。

经营开支分析

<u>以千美元计(百分比除外)</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零四年</u>	<u>年度比较</u>
	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>		<u>第一季</u>	
总经营开支	30,505	82,505	-63.0%	33,313	-8.4%
研究及开发	17,933	27,407	-34.6%	16,540	8.4%
一般及行政	6,591	25,476	-74.1%	10,688	-38.3%
销售及市场推广	2,494	2,544	-2.0%	1,747	42.8%
诉讼费用	-	23,153	-100.0%	-	-
递延股份报酬摊销	3,487	3,925	-11.2%	4,338	-19.6%

- 总经营开支较二零零四年第四季的 82,500,000 元降至 30,500,000 元，录得季度降幅 63.0%。
- 二零零五年第一季研发费用下降至 17,900,000 元，较上季的 27,400,000 元下降 34.6%，主要由于北京四厂非经常性工程开业成本于二零零四年第四季因尚未正式量产而作为研发费用列支；而在二零零五年第一季，以上费用随着北京四厂的量产，列支为销售成本。

- 一般行政费用从二零零四年第四季 25,500,000 元下降 74.1%至 6,600,000 元，差额主要因为本季与经营活动（如应收账款或应付账款）相关的汇兑收益为 3,600,000 元，二零零四年第四季为损失 11,300,000 元；诉讼费用和坏帐贮备的减少。

非经营收入（支出）

<u>以千美元计（百分比除外）</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零四年</u>	<u>年度比较</u>
	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>		<u>第一季</u>	
其它收入(支出)	(8,012)	12,358	-	609	-
利息收入	1,928	3,264	-40.9%	1,484	30.0%
利息支出	(7,688)	(4,581)	67.8%	(2,743)	180.2%
其它，净额	(2,252)	13,675	-	1,868	-
视为优先股派付的股息	-	-	-	(18,839)	-

- 其它非营业性溢利由二零零四年第四季的收益 12,400,000 元下降为本季的亏损 8,000,000 元。主要是因与融资或投资活动（如远期合约归类为其它业务收入/支出）相关的非经营性活动产生的汇兑损失 2,300,000 元，而二零零四年第四季为盈利 13,300,000 元；利息支出由二零零四年第四季的 4,600,000 元增加 3,100,000 元至 7,700,000 元。

3. 流动资金

<u>以千美元计（比率除外）</u>	<u>二零零五年第一季</u>	<u>二零零四年第四季</u>
现金及现金等价物	438,802	607,173
短期投资	10,349	20,364
应收账款	180,878	169,188
存货	174,525	144,018
其它	8,565	14,675
总流动资产	813,119	955,418
应付账款	333,442	364,334
长期借款的即期部份	228,625	191,986
其它	222,371	174,010
总流动负债	784,438	730,330
现金比率	0.6x	0.8x
速动比率	0.8x	1.1x

流动比率	1.0x	1.3x
------	------	------

- 现金及现金等价物由 607,200,000 元降至 438,800,000 元，主要由于资本开支所致。

应收账款 / 存货的各日走势

资本结构

<u>以千美元计 (百分比除外)</u>	<u>二零零五年第一季</u>	<u>二零零四年第四季</u>
现金及现金等价物	438,802	607,173
短期投资	10,349	20,364
长期票据的即期部分	4,833	-
长期票据	129,310	-
短期借款	133,499	91,000
长期借款的即期部份	228,625	191,986
长期借款	411,824	544,462
总借款	773,948	827,448
现金净额	(458,940)	(199,911)
股东权益	3,086,256	3,109,484
总借款对权益比率	25.1%	26.6%

- 总借款由二零零四年第四季的 827,400,000 元降至二零零五年第一季的 773,900,000 元，主要是由于长期借款的归还。

- 总借款对权益比率由二零零四年第四季的 26.6% 下降至二零零五年第一季的 25.1%。

4. 现金流量及资本开支

<u>以千美元计</u>	<u>二零零五年第一季</u>	<u>二零零四年第四季</u>
亏损净额	(29,995)	(11,216)
折旧及摊销	166,243	148,271
所购无形资产摊销	9,869	4,092
机器设备采购	(248,495)	(643,069)

现金变动净额	(168,371)	(342,992)
--------	-----------	-----------

资本开支计划

- 二零零五年第一季资本（包括无形资产购置）开支约为 343,000,000 元。
- 计划下的二零零五年资本开支约为 1,000,000,000 元，并且根据市场情况有所调整。

5. 二零零五年第二季指引

- 晶圆付运预期上升 16% - 18%。
- 使用率预计上升约至 86%-87%。
- 综合 ASP 预计与上季相比略有下调。
- 逻辑晶圆（包括铜接管件）的销售预计会下降 5%。
- 毛利率预计为与上季相比略有下调。
- 经营开支相对销售的百分比预计为百分之十几。
- 其它非营业性溢利预计增加至 10,000,000 元，主要由于长期借款的利息费用的增加。
- 资本开支约为 230,000,000 - 250,000,000 元。
- 折旧及摊销约为 190,000,000 元至 200,000,000 元。
- 递延补偿开支约为 7,000,000 元，其中约 4,000,000 元将于经营开支中列支，销售成本列支 3,000,000 元。

6. 近期公布

- 中芯国际与 Dolphin 联手提供 0.35 微米 EEPROM 微处理器内核（二零零五年四月二十六日）
- 中芯国际和芯成（上海）联合开发出面向汽车电子市场的高可靠性 EEPROM 技术（二零零五年四月八日）
- 中芯国际发布年度股东大会通告（二零零五年四月六日）
- 中芯国际发布澄清报章报导（二零零五年四月四日）

- 中芯国际发布建议持续关连交易（二零零五年四月四日）
- 中芯截至二零零四年十二月三十一日止三个月业绩公布（二零零五年三月二十九日）
- 二零零四年年度报告公布（二零零五年三月二十九日）
- 财务总监及合资格会计师（二零零五年三月二十九日）
- 中芯国际通过 TL9000 电信业质量管理体系认证（二零零五年三月二十一日）
- 中芯国际与苏州国芯签署合作协议（二零零五年三月十七日）
- 中芯国际参与 SEMICON China 2005 的系列活动（二零零五年三月十五日）
- 中芯国际推迟董事会会议召开（二零零五年三月十五日）
- 扩展一站式服务能力，中芯国际提供凸块服务（二零零五年三月四日）
- 股票成交量异常变动（二零零五年三月二日）
- 畅讯科技与中芯国际签订合作协议（二零零五年二月二十八日）
- 中芯截至二零零四年十二月三十一日止三个月销售额发布（二零零五年一月三十一日）
- 中芯国际与台积电达成协议（二零零五年一月三十日）

上述公布详情请参阅中芯网站 www.smics.com。

中芯财务资料

合并资产负债表
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零五年三月三十一日 (未经审核)	二零零四年十二月三十一日 (经审核)
资产		
流动资产:		
现金及现金等价物	438,801,533	607,172,570
短期投资	10,349,390	20,364,184
应收账款, 已扣除拨备 (二零零五年三月三十一日为 342,768 元, 二零零四年十二月三十一日为 1,105,165 元)	180,877,544	169,188,287
存货	174,525,252	144,017,852
预付款项及其它流动资产	6,732,846	12,842,994
待售资产	1,831,972	1,831,972
流动资产合计	813,118,537	955,417,859
土地使用权, 净额	38,976,538	39,197,774
物业、厂房及设备总额	3,354,240,115	3,311,924,599
购入无形资产, 净额	202,682,671	77,735,299
长期投资	2,810,309	-
资产合计	4,411,828,170	4,384,275,531
负债及股东权益		
流动负债:		
应付帐款	333,442,304	364,333,613
预提费用及其它流动负债	84,038,636	82,857,551
短期借款	133,498,761	91,000,000
长期票据的即期部份	4,833,421	-
长期借款的即期部份	228,625,170	191,986,372
应交所得税	-	152,000
流动负债合计	784,438,292	730,329,536

长期负债：		
长期票据	129,309,552	-
长期借款	411,824,480	544,462,074
长期负债合计	541,134,032	544,462,074
负债合计	1,325,572,324	1,274,791,610
承诺		
股东权益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零五年三月三十一日已发行股份为 18,233,297,823 股，未发行的股份为 18,232,179,139 股。	7,293,320	7,292,872
认股权证	32,387	32,387
额外缴入股本	3,289,197,990	3,289,724,885
应收股东票据	(339,157)	(391,375)
累计其它综合盈余	245,959	387,776
递延股票报酬	(43,794,707)	(51,177,675)
累计亏绌	(166,379,946)	(136,384,949)
所有股东权益合计	3,086,255,846	3,109,483,921
总负债及股东权益合计	4,411,828,170	4,384,275,531

合并营运报表
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零五年三月三十一日 (未经审核)	二零零四年十二月三十一日 (经审核)
销售额	248,808,088	291,841,924
销售成本	237,103,387	229,573,732
销售成本—摊销递延股票报酬	3,173,661	3,151,575
毛利	8,531,040	59,116,617
经营费用:		
研究和开发	17,933,336	27,406,568
一般管理	6,591,065	25,476,267
销售和市场推广	2,493,753	2,543,654
诉讼费用	-	23,153,105
摊销递延股票报酬*	3,486,827	3,925,186
经营费用总额	30,504,981	82,504,780
经营亏损	(21,973,941)	(23,388,163)
其它收入(支出):		
利息收入	1,928,135	3,263,727
利息支出	(7,688,304)	(4,580,725)
其它净额	(2,252,173)	13,675,198
其它净收入	(8,012,342)	12,358,200
税前亏损净额	(29,986,283)	(11,209,963)
所得税	8,714	186,044
净亏损	(29,994,997)	(11,216,007)

视为已派付优先股股息	-	-
普通股持有人应占亏损净额	(29,994,997)	(11,216,007)
每股股份收入净额，基本	(0.0017)	(0.0006)
每股美国预托股份收入净额，基本(1)	(0.0831)	(0.0311)
每股股份收入净额，摊薄	(0.0017)	(0.0006)
每股美国预托股份收入 净额，摊薄(1)	(0.0831)	(0.0311)
用作计算基本每股收入 净额的股份（以百万计）	18,054	18,006
用作计算摊薄每股收入 净额的股份（以百万计）	18,054	18,006
* 摊销递延股票报酬乃关于：		
研究和开发	1,309,708	1,175,503
一般和管理	1,573,391	2,289,305
销售及市场推广	603,728	460,378
总计	3,486,827	3,925,186

(1) 一股美国预托股份等于 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零五年三月三十一日 (未经审核)	二零零四年十二月三十一日 (经审核)
经营活动：		
普通股持有人应占亏损	(29,994,997)	(11,216,007)
视为已派付优先股股息	-	-
净亏损	(29,994,997)	(11,216,007)
净亏损至经营活动所得（所耗）现金净额对账的调整：		
出售厂房及设备的收益（亏损）	(3,434)	(69,916)
（冲销）呆账拨备	(762,397)	683,484
折旧及摊销	166,242,887	148,271,100
摊销购入无形资产	9,868,813	4,091,723
摊销递延股票报酬	6,660,488	7,076,761
非现金应付票据利息费用	1,173,682	-
长期投资亏损	69,691	-
营运资产及负债的变动：		
应收账款	(10,926,860)	17,363,354
存货	(30,507,400)	(9,260,846)
预付款及其它流动资产	5,873,806	(5,852,079)
应付账款	8,296,980	5,602,323
应付所得税	(152,000)	152,000
预提费用及其它流动负债	13,982,097	1,312,002
经营活动所得现金净额	139,821,356	158,153,899
投资活动：		
购买厂房及设备	(248,495,009)	(643,069,258)
购买购入无形资产	(2,400,500)	(3,967,841)
长期投资已付款项	(2,880,000)	-
出售短期投资	9,932,932	69,933,387
待售资产已收款项	1,878,435	3,158,817
出售厂房及设备收到款项	1,089	868,000

投资活动所耗现金净额	(241,963,053)	(573,076,895)
融资活动：		
短期借款所得款项	92,498,781	71,010,793
长期借款所得款项	28,475,559	-
偿还应付票据支付的款项	(25,000,000)	-
偿还长期借款支付的款项	(124,474,375)	-
偿还短期借款支付的款项	(50,000,000)	-
行使雇员购股权所得款项	196,032	297,743
收取应收认购款项	52,218	485,536
收取政府补贴收入	12,082,400	-
融资活动所得现金净额	(66,169,385)	71,794,072
汇率变动的的影响	(59,955)	136,585
现金及现金等价物减少净额	(168,371,037)	(342,992,339)
现金及现金等价物—二零零五年一月一日	607,172,570	950,164,909
现金及现金等价物—二零零五年三月三十一日	438,801,533	607,172,570

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席及执行董事张汝京、非执行董事蔡来兴、姚方（蔡来兴的替任董事）、独立非执行董事徐大麟、周延鹏、川西刚、萧崇河、陈立武及王阳元。

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
主席
张汝京
香港，二零零五年四月二十九日

* 仅供识别